



R4D封装模组

R4D是杏林睿光半导体AW系列多功能激光模组，单一波长输出，可集成2-3个主波长激光，具有较高的输出功率，光纤插拔式设计。配置指示光、光纤开关、PD探测器、热敏电阻等功能。

主要功能特点

- ◆ 可靠性高
- ◆ 功率稳定
- ◆ 光斑均匀
- ◆ 散热好
- ◆ 波长可选

应用

激光美容
医疗应用
材料加工

技术参数 (25°C)

封装形式		R4D		
中心波长 (nm)		808	9XX	1064
光学	连续输出功率 P_{op} (W)	40	50	40
	波长公差 (nm)	±10		
	光谱宽度 $\Delta\lambda$ (nm)	<6		
	波长随温度特性 $\Delta\lambda/\Delta T$ (nm/°C)	0.3		
指示光	输出功率 P_a (mW)	2		
	波长 λ_a (nm)	650±10		
	电压 V_a (V)	2.2, 5.0		
电学	阈值电流 I_{th} (A)	3	2	2
	工作电流 I_{op} (A)	18	22	18
	工作电压 V_{op} (V)	6.2	6	6
	微分效率 η_{es} (W/A)	2.6	2.5	2.5
	PD电流 I_{pd} (μA)	<8000		
	热敏电阻参数 R_t (kΩ/β (25°C))	10±1%/3450		
光纤	光纤芯径 D_{core} (μm)	400		
	光纤包层直径 D_{clad} (μm)	440		
	光纤涂覆层直径 D_{buffer} (μm)	720		
	数值孔径 NA	0.22		
	连接器	SMA905		

其他参数

参数	工作温度 (°C)	工作相对湿度 (%)	存储温度 (°C)	存储相对湿度 (%)	引脚焊接温度 (max/°C)
最小	10	-	-20	-	-
最大	30	75	70	90	250(10Sec.)

